



Nano-SIM 卡插座与标准 Nano-SIM 卡以及特别定制的 Micro-SIM 卡可无缝插配，为智能手机和平板设备提供了优异的可靠性

随着用户身份模块 (SIM) 不断的微型化以及 Nano-SIM - 第 4 代 SIM 卡标准 - 的引入，为更多的电子器件、更大的电池和更轻薄的手机设计节省了 PCB 空间，却也使得 micro-SIM 卡用户现有的卡因太大太厚而无法插入标准尺寸的 Nano-SIM 卡插座中。一些用户试图修剪 micro-SIM 卡以适应较小的插座，却发现 micro-SIM 卡依旧太厚而无法插入仅接受的标准、0.67mm 厚的 Nano-SIM 卡插座。

Molex 公司设计了一款厚度为 1.30mm 的 Nano-SIM 卡插座，支持标准厚度 (0.67mm) Nano-SIM 卡以及更厚 (0.76mm) 的特别定制的 micro-SIM 卡的使用。这一系列产品与 0.30mm 块型 SIM 连接器 (78545 系列) 配合使用，提供了一个高接触法向力 (0.30N)，以确保卡与插座之间接触完整性和电气稳定性。

3 片插座设计以其独立的块型 SIM 连接器和弹出器托盘降低了 SMT 翘曲的风险，尤其是在高 IR 处理温度的情况下。

这一套紧凑的组件结合卡片极化和检测、以及托盘锁定功能才能变得完整。取下 SIM 卡很简单。只需将一个回形针 (直径 0.80mm) 插入位于托盘盖右侧的针孔，托盘将立刻弹出。

所有部件都不含卤素，具有环境可持续性，并在压纹卷带包装后装运。

欲知更多信息，请访问我们的网站：www.molex.com/link/nanosim.html

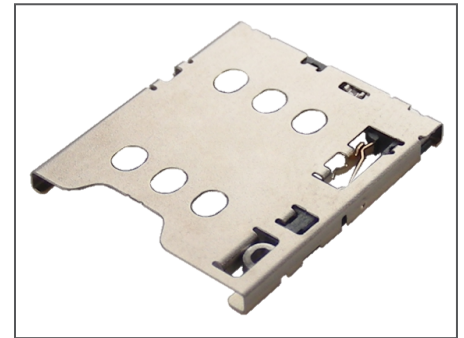
带 Nano-SIM 卡插座外壳的块型 SIM 连接器

(配合客户提供的弹出器托盘使用)

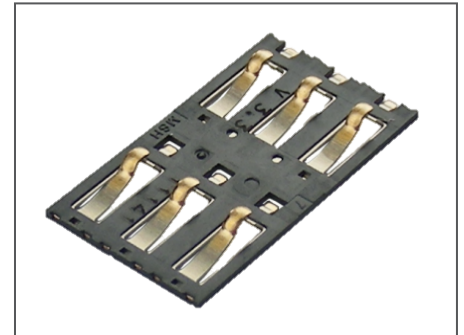
78545 SIM 连接器，块型，0.30毫米厚

78790 Nano-SIM 卡插座外壳，1.30mm 厚

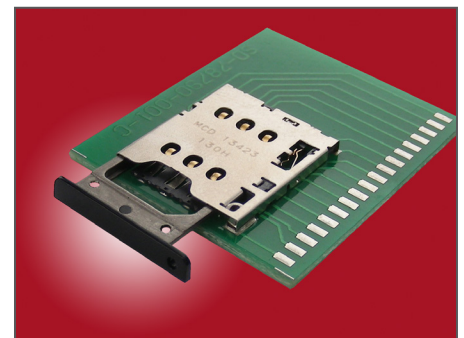
配合 弹出器托盘
(客户提供、根据要求定制)



Nano-SIM 卡插座外壳，1.30mm 厚
(78790 系列)



块型 SIM 连接器，0.30mm 厚
(78545 系列)



建议与 SIM 连接器和配有客户提供弹出器托盘的 Nano-SIM 卡插座外壳组装

特性和优点

块型 SIM 连接器 (78545 系列)

高接触法向力 (0.30N)	与卡和插座外壳配合使用时, 改善了卡-插座 (电气) 触点
0.38 微米镀金 (Au) 触点和 0.05 微米镀闪金焊尾	在使用寿命期间, 通过提供稳定的低接触电阻, 确保连接器的高可靠性
0.30mm 连接器厚度	在薄型应用中提供最大的垂直空间节省
触点端子圆形几何结构	确保 SIM 卡出入期间平稳滑行
不含卤素、无铅	具有环境可持续性

规格

块型 SIM 连接器 (78545 系列)

参考信息

包装: 压纹卷带
可搭配使用的产品:
Nano-SIM 或 micro-SIM 修剪卡
使用的端子: 铜合金
设计单位: 毫米
RoHS: 是
不含卤素: 是
满足欧洲 Glow-Wire 标准: 否

电气

电压 (最大值): 15 伏特 (直流电)
电流 (最大值): 每个触点 0.5 安培
低电平触点电阻 (最大值):
100 毫欧 (初始值)
电介质承受电压: 500 伏特交流电
绝缘电阻 (最小值): 1000 兆欧

机械

接触法向力: (最小值) 0.30N
托盘与卡之间插入力 (最小值):
0.30N
托盘与卡之间拔出力 (最大值):
20N
焊点剥离强度 (最小值): 20N
耐用性:
每小时 240-550 次至 500 次

物理

外壳:
LCP、UL94V-0、玻璃纤维填充、黑色
触点: 铜合金
镀层:
接触区域 —
0.38 微米 金 (Au)
焊尾区域 —
0.05 微米 镀闪金 (Au)
其他区域 —
镀镍
垫板 —
2.00μm 镍 (Ni)
工作温度:
-30 至 +85 °C

特性和优点

插座外壳 (78790 系列)

1.30mm 插座外壳设计厚度	适合标准 0.67mm Nano-SIM 卡以及 0.76mm 厚的 micro-SIM 修剪卡
微型插座封装	节省昂贵的 PCB 空间, 实现最大空间节省和成本节约
托盘锁定特性	插入时, 确保托盘安全锁定
带有先接/后断功能的探测开关	可靠的托盘和 SIM 卡检测
完整的外壳焊片和轴外壳不锈钢焊片	强化插座和外壳元件的焊接压紧
卡片极化特性	配合插座使用时, 确保正确的插卡方向

规格

插座外壳 (78790 系列)

参考信息

包装: 压纹卷带
 可搭配使用的产品:
 Nano-SIM 或 micro-SIM 修剪卡
 所使用的端子: 铜合金
 设计单位: 毫米
 RoHS: 是
 不含卤素: 是
 满足欧洲 Glow-Wire 标准: 否

电气

电压 (最大值): 10 伏特 (直流电)
 电流 (最大值): 每个触点 0.5 安培
 低电平触点电阻 (最大值):
 100 毫欧 (初始值)
 电介质承受电压: 500 伏特交流电
 绝缘电阻 (最小值): 1000 兆欧

机械

接触法向力: (最小值) 0.30N
 托盘与卡之间插入力 (最小值):
 0.30N
 托盘与卡之间拔出力 (最大值):
 20N
 耐用性:
 最多 1000 次, 每小时 720 次

物理

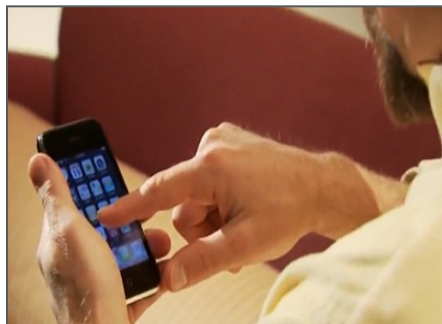
外壳: 嵌件成型、LCP、UL94V-0
 触点: 铜合金
 镀层
 (78790 插座探测弹簧):
 接触区域 —
 0.127 μ m 金 (Au)
 焊尾区域 —
 1.27 μ m 锡 (Sn)
 垫板 —
 1.27 μ m 镍 (Ni)
 镀层 (78790 插座外壳):
 触点和焊接区域 —
 0.025 μ m 金 (Au)
 垫板 —
 1.27 μ m 镍 (Ni)
 镀层 (78790 插座轴):
 焊尾区域 —
 1.27 μ m 锡 (Sn)
 工作温度:
 -40 至 +85°C

应用

智能电话和移动设备
 - SIM 卡
 - 其他移动设备



平板电脑



智能手机

带 Nano-SIM 卡插座外壳的块型 SIM 连接器



移动 Wi-Fi* 设备

订购信息

订单编号	元件	外形高度 (mm)	焊点数目
78545-0010	块型 SIM 连接器, 0.30mm 厚	0.30mm	6
78790-1001	带探测开关的 Nano-SIM 卡插座外壳 (托盘由客户提供)	1.30mm	7

*Wi-Fi 为 Wi-Fi 联盟的注册商标

www.molex.com/link/nanosim.html
www.chinese.molex.com/link/nanosim.html